



推奨基板取付け寸法
PC 基板厚: 1.6±0.1 (非累積公差) (コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE) (CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER COLOR: BLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
 - FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
 - FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
 - FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
 - FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
 - FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- 注記
1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂 色: 黒
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土にスズめっき

△6	△4	178308-5
△6	△3	178308-3
△6	△2	178308-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

C	REVISED (FJ00-0039-03)	T.S.H.	25 APR '93
B	REVISED (FJ00-0114-03)	T.S.M.	3/23 '95
A	REVISED (FJ00-2183-95)	K.I.S.M.	2/8 '93
O	RELEASED (FJ00-0017-93)	Y.T.S.M.	2/8 '93
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK

Copyright © 1993
AMP (Japan) LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan

WIRE RANGE: mm (AWG) -)
INSULATION DIA: mmφ

NAME: ダイナミック D3100 水平タイプ
20 脚 ヘッダーアセンブリ
20 POS DOUBLE ROW
HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100

(GENERAL TOLERANCE)
100μm ±0.3
100μm 300μm ±0.4
300μm 1000μm ±0.45

SIZE LOC NUMBER: A3 J C-178308
SCALE: 2-1 REV. C SHEET 1 OF 1

DR. 20-JAN-'93 Y.TANAKA
CHK. 8-FEB-'93 S.MANABE
DE. 20-JAN-'93 Y.TANAKA
APP. 8-FEB-'93 S.MANABE

NUMBER 178308
METRIC
3rd ANGLE PROJECTION
PRINT DIST
DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT
AMP-J REV.10/83